

Communiqué de presse

X-FAB va bénéficier d'un financement du PIIEC ME/CT européen pour son innovation dans la technologie des semi-conducteurs

Tessengerlo – 18 octobre 2023

X-FAB Group, le principal fondeur spécialisé dans la production de semi-conducteurs à signaux analogiques/mixtes, est sur le point de bénéficier d'importantes subventions dans le cadre du nouveau Projet Important d'Intérêt Européen Commun pour la Microélectronique et les Technologies de Communication (PIIEC ME/CT). Le financement, d'un montant total d'environ 80 millions d'euros, sera accordé par les gouvernements participants de la France et de l'Allemagne. Ce programme soutient l'innovation dans les domaines de la microélectronique et des solutions de communication, jouant un rôle vital dans la réalisation des objectifs européens en matière de digitalisation, de développement durable et de souveraineté technologique.

Le financement s'étendra sur trois usines de X-FAB, chacune se concentrant sur des aspects distincts de la technologie des semi-conducteurs. Celle de Corbeil-Essonnes en France se spécialise dans les capteurs intelligents et les circuits de commande, les nouvelles architectures, la photonique et les technologies RF. Le site a récemment lancé sa production en 110 nm sur tranches de 200 mm, grâce à la technologie de pointe BCD-sur-SOI développée dans le cadre du programme IPCEI ME précédent.

Le site d'Erfurt en Allemagne travaille sur le développement d'une plateforme de fabrication unique et novatrice pour les systèmes de capteurs intégrés intelligents. X-FAB enrichit ainsi considérablement son offre technologique dans les domaines des systèmes de capteurs intelligents, de l'intégration 3D et de l'intégration de puces hétérogènes au

moyen de l'impression par micro-transfert et contribue à élargir l'état de l'art international en matière de technologies d'intégration de systèmes et d'assemblage avancé.

Sur le site d'Itzehoe en Allemagne, X-FAB se concentrera sur le développement et la mise en œuvre de nouvelles méthodes de traitement des tranches en verre.

X-FAB reconnaît l'importance stratégique du financement du PIIEC ME/CT dans ses efforts pour développer des technologies innovantes dans le domaine des composants semi-conducteurs nouvelle génération. L'initiative vise à répondre aux futures demandes des marchés de l'automobile, du médical et de l'industrie, adressant les besoins croissants en connectivité, en capteurs intelligents et en dispositifs de puissance à efficacité énergétique améliorée.

Le financement soutiendra un large éventail de technologies émergentes, servant une multitude d'applications, notamment la gestion intelligente des batteries, les capteurs médicaux, les capteurs de lumière (tels que LiDAR et OLED), les dispositifs de communication conformes aux normes futures de la 6G, la 5G mmWave, les systèmes de capteurs intelligents et les dispositifs microfluidiques pour les applications biotechnologiques.

Pour ce faire, X-FAB prévoit de collaborer avec plus de 40 partenaires industriels clés, allant des PME aux grandes entreprises, ainsi qu'avec des institutions académiques. Ces collaborations couvriront divers aspects de la chaîne de valeur des semi-conducteurs.

"Nous exprimons notre gratitude envers le PIIEC ME/CT, qui soutient la recherche et le développement ici chez X-FAB. Notre engagement consiste à repousser continuellement les limites de la technologie des semi-conducteurs. Nous sommes déterminés à développer des innovations qui répondent à des défis sociétaux importants, tel que le changement climatique, en favorisant la transition vers la mobilité électrique, ainsi qu'en offrant des solutions médicales fiables et efficaces pour répondre aux besoins de nos populations croissantes et dont l'espérance de vie continue d'augmenter", note Rudi De Winter, PDG de X-FAB.

Remerciements

Allemagne : Ministère fédéral de l'Économie et de la Protection du Climat (BMWK), État libre de Thuringe

France : Le projet est soutenu et financé par le programme français "France 2030" :

<https://www.gouvernement.fr/france-2030>

– FIN –

Glossaire

BCD-sur-SOI - BCD (Bipolar-CMOS-DMOS) silicium sur isolant

LiDAR - Détection et télémétrie par la lumière

OLED - Diode électroluminescente organique

RF - Radiofréquence

À propos de X-FAB

X-FAB est le principal groupe de fonderie analogique/mixte et MEMS fabricant des tranches de silicium pour les secteurs de l'automobile, de l'industrie, de la consommation, de la médecine et d'autres applications. Ses clients à l'échelle globale bénéficient des normes de qualité les plus élevées, de l'excellence X-FAB en matière de fabrication et de solutions innovantes grâce aux procédés CMOS et SOI modulaires de X-FAB dans des géométries allant de 1,0 μm à 110 nm, ainsi que de ses procédés spéciaux en carbure de silicium et MEMS à longue durée de vie. Les circuits intégrés analogiques-numériques (CI mixtes), les capteurs et les microsystèmes électromécaniques (MEMS) de X-FAB sont fabriqués sur six sites de production en Allemagne, en France, en Malaisie et aux États-Unis. X-FAB compte plus de 4200 employés dans le monde entier. Pour en savoir plus, consultez le site xfab.com.

X-FAB Contact Presse

Anja Noack

MarCom Manager

X-FAB Silicon Foundries

+49-361-427-6162

anja.noack@xfab.com